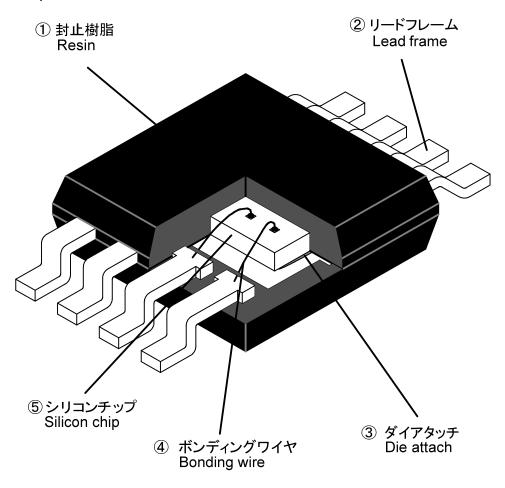
## MSOP-8A構造図 MSOP-8A Perspective

## **TOIREX**

RoHS対応品 RoHS Compliance



| 項目       |                   | 材 料                          | 備 考                        |
|----------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| Item     |                   | Material                     | Note                       |
| 1        | 封止樹脂              | エポキシ樹脂                       | 難燃グレード/Flammability rating |
|          | Resin             | Epoxy resin                  | UL94V-0                    |
| 2        | リードフレーム           | 銅系                           |                            |
|          | lead frame        | Copper alloy                 |                            |
|          | 端子処理              | 鉛フリーはんだメッキ                   |                            |
|          | Outer pad plating | Lead(Pb) free solder plating |                            |
| 3        | ダイアタッチ            | エポキシ                         |                            |
|          | Die attach        | Ероху                        |                            |
| 4        | ボンディングワイヤ         | Au                           |                            |
|          | Bonding wire      |                              |                            |
| <b>⑤</b> | シリコンチップ           | Si                           |                            |
|          | Silicon chip      |                              |                            |

| 捺印表示    | レーザー          |
|---------|---------------|
| Marking | Laser marking |